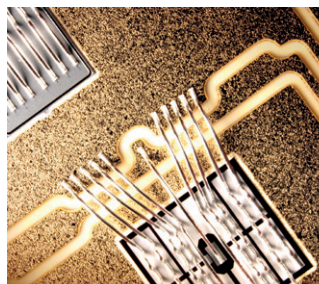


Präzise Inline-Inspektion von Drahtbonds

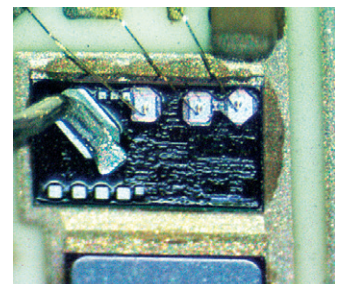
Das System S6053BO-V von Viscom zeichnet sich durch höchste Genauigkeit in der automatischen optischen Drahtbondinspektion aus. Durch individuell konfigurierbare Transportoptionen lassen sich Keramiksubstrate unterschiedlichster Größe und Ausprägung sicher inspizieren.

Drahtbonds und SMD-Bestückung werden kombiniert geprüft. Hochauflösende Kameras erfassen sämtliche Bondstellen und -drähte. Die Viscom-Inspektionssoftware ist für höchste Prüftiefe und Genauigkeit ausgelegt. Die Inspektion umfasst u. a. Drahtverläufe, Dies und Bauteillagen. Dabei ist es ganz gleich, ob die Verbindungen aus Kupfer, Aluminium oder Gold bestehen und ob es sich um Bändchen, Dickdraht oder Dünndraht handelt. Selbst ein Drahtdurchmesser von 17 µm wird verlässlich geprüft. Das System detektiert ebenfalls Beschädigungen und Lageabweichungen von Bauelementen.

Auf einem Programmierplatz von Viscom lassen sich die Prüfprogramme offline erstellen und optimieren. Dazu dient das Bildmaterial einer zuvor aufgenommenen Video-Basis. Die Standardbibliothek stellt Prüfmuster für Die-Bonds, Ball-Wedge-, Wedge-Wedge- und Security-Bonds bereit. Der Inspektionsumfang lässt sich individuell erweitern. In Verbindung mit einer leistungsfähigen Viscom-SPC-Auswertung können vielfältige Rückschlüsse auf den Prozess erfolgen.



Fehlererkennung an Multidrahtverbindungen



Inspektion verschiedener Drahtstärken



**High-End-Lösung für die
Inline-Inspektion**

**Individuell konfigurierbarer
Transport**

**Kompatibel mit allen
Bond-Kameramodulen von Viscom**

**Besonders hohe Genauigkeit
und Prüftiefe**

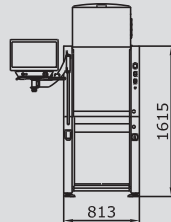
**Remote-Diagnose, Hotline
und Vor-Ort-Service**

Bond

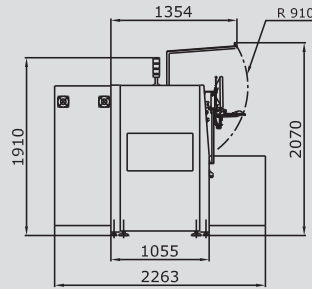
Technische Daten



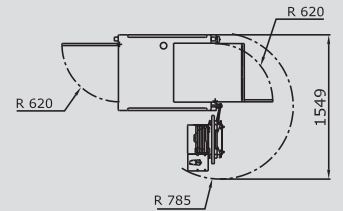
Vorderansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Angaben in mm*

		S6053BO-V		
	Transportsystem	Einzelspur	Doppelspur	Doppel-Shuttle
	Prüfkonzept	Einzelprüfung		
Inspektionsumfang	Bond	Ball-Bond, Wedge-Bond, Draht, Die/SMD, Bändchen		
Sensorik	Standardkonfiguration XM Bond HR*			
	Anzahl der Module pro Maschine	1		
	Anzahl Kameras	1		
	Bildpunktgröße	4,5 µm/Pixel		
Software	Bedienoberfläche	Viscom EasyPro		
	SPC	Viscom SPC (statistische Prozesskontrolle), offene Schnittstelle (optional)		
	Verifikationsplatz	Viscom HARAN		
	Remote-Diagnose	Viscom SRC (Software Remote Control) (optional)		
	Programmierplatz	Viscom PST34 (optional)		
Systemrechner	Betriebssystem	Windows®		
	Prozessor	Intel® Core™ i7		
Substrathandling	Max. Substratgröße	280 mm x 300 mm (L x B)	280 mm x 130 mm (L x B)	210 mm x 130 mm (L x B)
	Übergabehöhe	860 - 1180 mm ± 20 mm		
	Substratfixierung	Vakuum oder mechanische Klemmung		
	Obere Durchfahrtshöhe	Bis zu 35 mm		
Prüfgeschwindigkeit		> 1000 Wirebond-Verbindungen/Min., abhängig von den Eigenschaften des Prüflings		
Sonstige Systemdaten	Verfahr-/Positioniereinheit	Synchron-Linearmotoren		
	Schnittstellen	SMEMA, SV70, kundenspezifisch		
	Anschlusswerte	400 V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A, 4 - 6 bar Arbeitsdruck		
	Systemmaße	813 - 1000 mm x 1615 mm x 1055 mm (B x H x T)		
	Gewicht	800 kg		

*Weitere Sensoriken und Substratgrößen auf Anfrage